

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年10月6日 (06.10.2005)

PCT

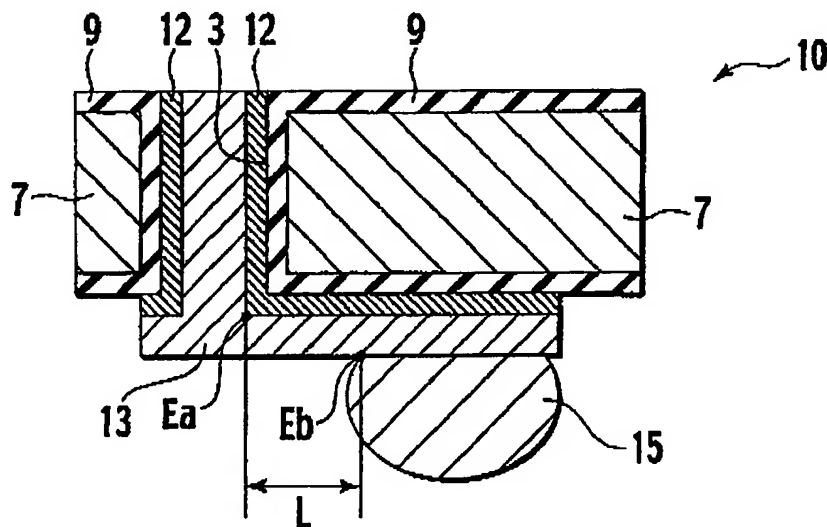
(10) 国際公開番号  
WO 2005/093827 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 23/12, 21/60 (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 虎ノ門平タワー Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014637
- (22) 国際出願日: 2004年10月5日 (05.10.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2004-092667 2004年3月26日 (26.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社フジクラ (FUJIKURA LTD.) [JP/JP]; 〒1358512 東京都江東区木場1丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 和田 英之 (WADA, Hideyuki) [JP/JP]; 末益 龍夫 (SUEMASU, Tatsuo) [JP/JP].
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GH, GI, GM, GR, GU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

/続案有/

(54) Title: THROUGH WIRING BOARD AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 貫通配線基板及びその製造方法



(57) Abstract: A through wiring board provided with through wiring extending through the through hole of the board. The through wiring board comprises a through hole made through the board, through extension wiring provided in the through hole and extending on one side of the through wiring board up to a position at a predetermined distance from the through hole, and a conductive hump formed on the through extension wiring except the through hole position.

(57) 要約: 基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において、前記基板に設けられた貫通孔と、前記貫通孔に充填されると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板の一方の面上に伸延して形成される貫通伸延配線と、前記貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に形成された導電性を有するパンプと、を具備している。

WO 2005/093827 A1